2027年3月期 第2四半期
決算説明資料

太陽ホールディングス株式会社
東証プライム　4626
2026年11月6日

本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

TAIYO 太陽ホールディングス

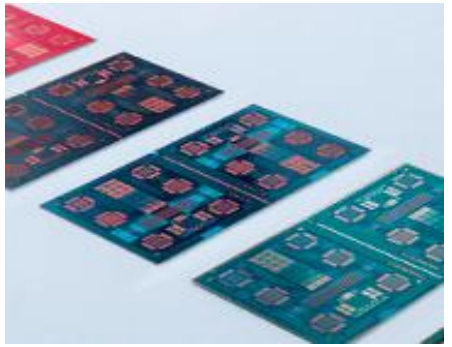
Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

当社グループの事業セグメント

エレクトロニクス事業（エレキ事業）

プリント基板（PCB）用部材を始めとする
電子部品用化学品部材の開発・製造販売
及び仕入販売





医療・医薬品事業（医薬事業）

医療用医薬品の製造販売・製造受託、
歯科技工物の製造・販売





ICT&S事業

ICT事業、ファインケミカル事業、
エネルギー事業及び食糧事業等





Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

2027年3月期 第2四半期 トピックス

エレキ事業

- 売上高は、前年同期比で25%増加
  〈要因〉円安進行に加え、6月出荷分より一部製品価格を改定

為替影響	＋	円安が13.5円進行したことにより業績にプラスの影響 期中平均為替レート：　当期1米ドル　160.0円 前年同期1米ドル　146.5円
価格改定	＋	原材料費等の高騰を受けた、一部製品の価格改定により増収
PKG基板用部材	＋	AIの普及を背景とした需要が継続し、メモリ向けのドライフィルム製品を中心に販売数量増加
リジッド基板用高機能部材	＋	衛星通信基板用途や車載基板用途、高密度実装配線（HDI）基板用途中心に販売数量増加
	－	ディスプレイ関連部材（白色ドライフィルム）の販売数量減少

医薬事業

- 売上高は、前年同期比で7%減少
  〈要因〉製造受託事業における、プロダクトミックスの変化による減収

製造受託事業	－	製造委託元の生産計画変更に伴うプロダクトミックスの変化による減収
製造販売事業	－	鎮咳去痰薬における需要の減少に伴う販売数量減少
	－	選定療養制度における対象品目の販売数量減少

全社

- 2027年3月期の通期業績予想を上方修正
- 投資有価証券売却益（特別利益）の計上
- KJ005株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定時期の変更

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

連結業績

単位：百万円	① 2026年3月期 上半期 実績	② 2027年3月期 上半期 実績	②-① 前年 同期比	(②-①)÷① 増減率	③ 2027年3月期 上半期 業績予想 (7月31日発表)	②÷③ 進捗率	④ 2027年3月期 通期 業績予想 (7月31日発表)	②÷④ 進捗率
売上高	**67,830**	**78,480**	*10,650*	*16%*	**75,900**	*103%*	**149,100**	*53%*
営業利益	**15,187**	**22,230**	*7,042*	*46%*	**18,900**	*118%*	**36,400**	*61%*
経常利益 *3	**14,562**	**22,739**	*8,177*	*56%*	**19,200**	*118%*	**36,300**	*63%*
親会社株主に帰属する当期純利益	**11,022**	**17,305**	*6,282*	*57%*	**13,100**	*132%*	**25,400**	*68%*
円・USDレート	146.5	160.0	*13.5*		***1**		***2**	
EBITDA	**19,477**	**26,630**	*7,152*	*37%*	**23,200**	*115%*	**45,300**	*59%*
営業利益率	22%	28%			25%		24%	
EBITDA マージン	29%	34%			31%		30%	

*1 円・USDレート：2027年3月期第1四半期（実績）160.5円、第2四半期（期初業績予想据え置き）150.0円
*2 円・USDレート：2027年3月期第1四半期（実績）160.5円、第2～第4四半期（期初業績予想据え置き）150.0円
*3 2027年3月期第2四半期より表示方法の変更を行ったため、2026年3月期第2四半期の経常利益については、表示方法の変更を反映させた、組替え後の数値を記載。

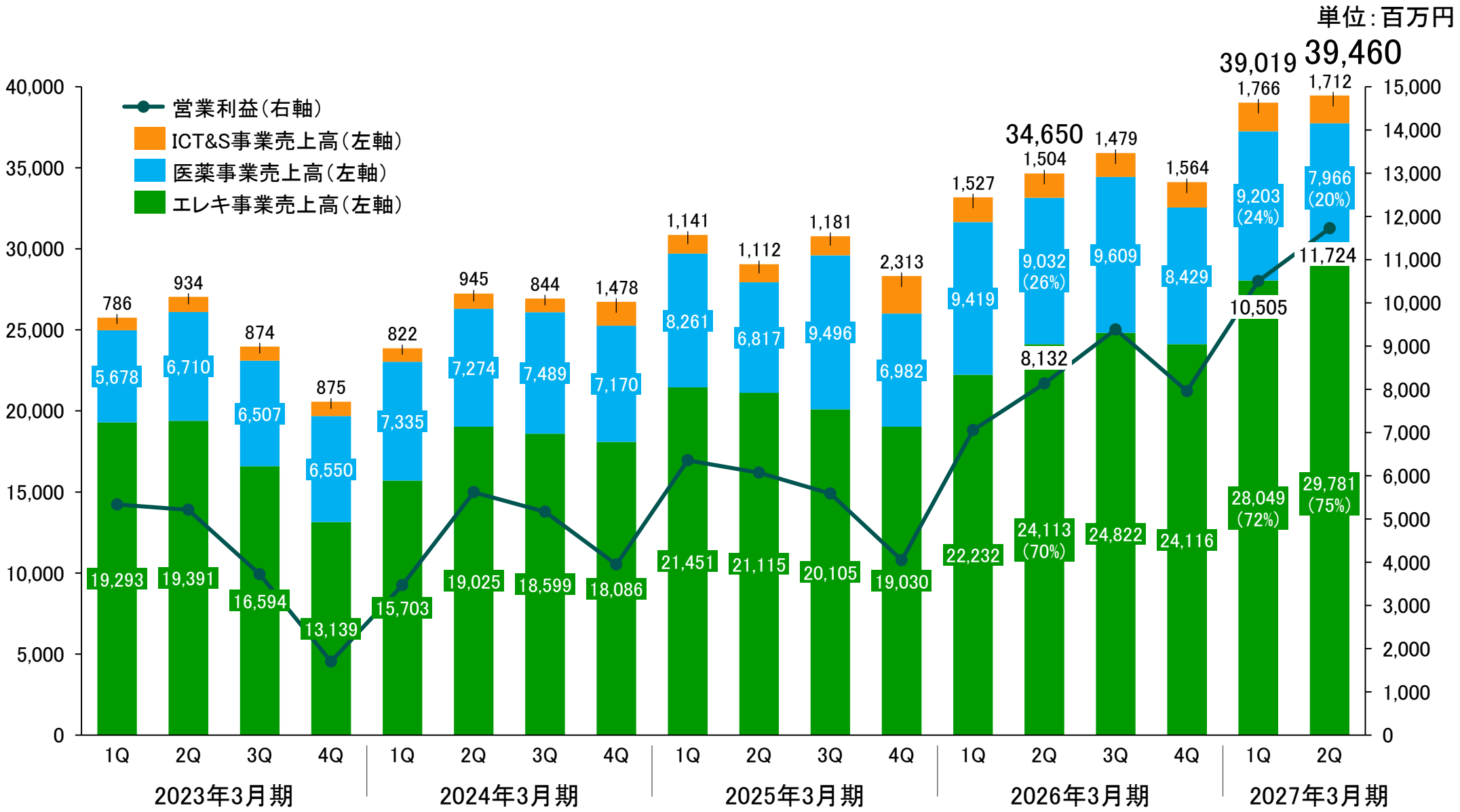
Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

セグメント別業績（売上高・営業利益・EBITDA）

	単位：百万円	① 2026年3月期 上半期 実績	② 2027年3月期 上半期 実績	②-① 前年同期比	(②-①)÷① 増減率	③ 2027年3月期 上半期 業績予想 (7月31日発表)	②÷③ 進捗率	④ 2027年3月期 通期 業績予想 (7月31日発表)	②÷④ 進捗率
エレキ事業	売上高	46,346	57,830	*11,484*	*25%*	54,400	*106%*	105,000	*55%*
	営業利益	13,794	20,837	*7,042*	*51%*	17,600	*118%*	33,400	*62%*
	営業利益率	30%	36%			32%		32%	
	EBITDA	15,616	22,784	*7,167*	*46%*	19,500	*117%*	37,300	*61%*
	EBITDAマージン	34%	39%			36%		36%	
医薬事業	売上高	18,451	17,169	*△1,281*	*△7%*	18,300	*94%*	37,500	*46%*
	営業利益	2,426	1,499	*△926*	*△38%*	1,800	*83%*	4,000	*37%*
	営業利益率	13%	9%			10%		11%	
	EBITDA	4,387	3,452	*△934*	*△21%*	3,800	*91%*	8,000	*43%*
	EBITDAマージン	24%	20%			21%		21%	
ICT&S事業	売上高	3,031	3,479	*447*	*15%*	-	-	-	-
	営業利益	18	260	*242*	*1,321%*	-	-	-	-
	営業利益率	1%	7%			-	-	-	-
全社費用	営業損益	△1,052	△367	*684*		-	-	-	-

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

四半期別推移(売上高・営業利益)



Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

太陽ホールディングス

BSの概況

BS前期比較

単位：百万円

	26/3末	26/9末	増減		26/3末	26/9末	増減
現金及び預金	43,203	49,442	6,238	支払手形及び買掛金	9,501	11,602	2,100
売上債権*1	34,317	38,204	3,886	短期借入金*3	15,754	16,833	1,079
棚卸資産*2	21,653	24,979	3,325	長期借入金	41,098	33,037	△8,060
上記以外	3,939	3,212	△726	上記以外	19,816	20,647	830
流動資産合計	**103,115**	**115,838**	12,723	**負債合計**	**86,170**	**82,120**	△4,050
有形固定資産	70,501	72,952	2,450	株主資本	100,983	118,287	17,304
無形固定資産	14,465	13,487	△978	その他の包括利益累計額	14,761	15,427	665
投資その他の資産	13,846	13,579	△266	非支配株主持分	12	22	10
固定資産合計	**98,813**	**100,019**	1,205	**純資産合計**	**115,757**	**133,737**	17,980
資産合計	**201,928**	**215,858**	13,929	**負債純資産合計**	**201,928**	**215,858**	13,929
				自己資本比率	57.3%	61.9%	4.6%

*1 売上債権：受取手形＋売掛金＋契約資産
*2 棚卸資産：商品及び製品+仕掛品+原材料及び貯蔵品
*3 短期借入金：短期借入金+1年内返済予定の長期借入金

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

2027年3月期 通期業績予想修正

✓ 通期業績予想を修正しました。修正の理由は以下の通りです。
- 第2四半期においてエレキ事業の業績が予想を上回る結果となったこと。
- 第2四半期に投資有価証券売却益を特別利益として計上したこと。

単位：百万円		2027年3月期 通期業績予想 (7月31日発表)*1		2027年3月期 通期業績予想 (11月6日発表)*2		増減比	
		金額	利益率	金額	利益率	金額	率
連結	売上高	149,100		152,500		+3,400	+2%
	営業利益	36,400	24%	39,600	26%	+3,200	+9%
	経常利益	36,300	24%	39,700	26%	+3,400	+9%
	親会社株主に帰属する当期純利益	25,400	17%	29,600	19%	+4,200	+17%
	EBITDA	45,300	30%	48,500	32%	+3,200	+7%
エレキ事業	売上高	105,000		108,400		+3,400	+3%
	営業利益	33,400	32%	36,600	34%	+3,200	+10%
	EBITDA	37,300	36%	40,500	37%	+3,200	+9%
医薬事業	売上高	37,500		37,500		−	−
	営業利益	4,000	11%	4,000	11%	−	−
	EBITDA	8,000	21%	8,000	21%	−	−

*1 円・USDレート：2027年3月期第1四半期（実績）160.5円、第2～第4四半期（期初業績予想据え置き）150.0円
*2 下半期の業績予想は2026年7月31日に開示した業績予想を据え置き、エレキ事業の上半期業績予想を実績値に更新し、第2四半期の特別利益を踏まえ、連結業績予想を修正。
円・USDレート：上半期（実績）160.0円、下半期（期初業績予想据え置き）150.0円

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

特別利益の計上

✓ 当社は、四国化成ホールディングス株式会社が実施した同社普通株式の売出しに際し、当社が保有していた同社普通株式の全部を売却し、特別利益を約20億円計上しました。

特別利益の概要

計上金額	投資有価証券売却益　2,052百万円	
発生事象の概要	四国化成ホールディングス株式会社（コード：4099　東証プライム）が実施した同社普通株式の売出しに際し、売出人の一社として参加し、当社が保有していた同社普通株式の全部を売却。	
	売却理由	保有資産の効率化を図るため
	売却した投資有価証券	四国化成ホールディングス株式会社 普通株式
	売却した株式数	1,490,000株
	売却総額	2,944百万円（1株につき1,976.08円）

＊ 詳細については、下記の2026年9月9日開示資料をご参照ください。
「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況

✓ 当社は、KJ005株式会社が2026年11月下旬頃を目途に本公開買付けの開始を目指している旨を、2026年10月9日に公表しております。*

公開買付け実施に向けた進捗状況

国内外の競争法並びに国内外の投資規制法令に基づく必要な手続及び対応(以下「本手続等」)の進捗状況について、下記の連絡を受けております。

競争法に基づく必要な手続及び対応

完了	日本、台湾、ドイツ、チュニジア、ベトナム
未了	中国

投資規制法令に基づく必要な手続及び対応

完了	米国
未了	日本

今後のスケジュール

KJ005株式会社としては、本手続等の完了見通しが立ち、本公開買付けの実施条件が整い次第、本公開買付けを開始することを予定しているとのことです。

公表日	本手続等の完了予定時期	本公開買付けの開始予定時期
2026年3月31日	―	2026年10月上旬頃
2026年10月9日	2026年11月中	2026年11月下旬頃

＊ 詳細については、下記の2026年10月9日開示資料をご参照ください。
「(開示事項の経過)KJ005株式会社による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

エレクトロニクス事業

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

エレクトロニクス事業　用語説明

用語	内容
PCB (Printed Circuit Board)	プリント基板
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト(レジストインキ)
PKG (Package)	半導体パッケージ
DF (Dry Film)	ドライフィルム
BU (Build-up)	ビルドアップ

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

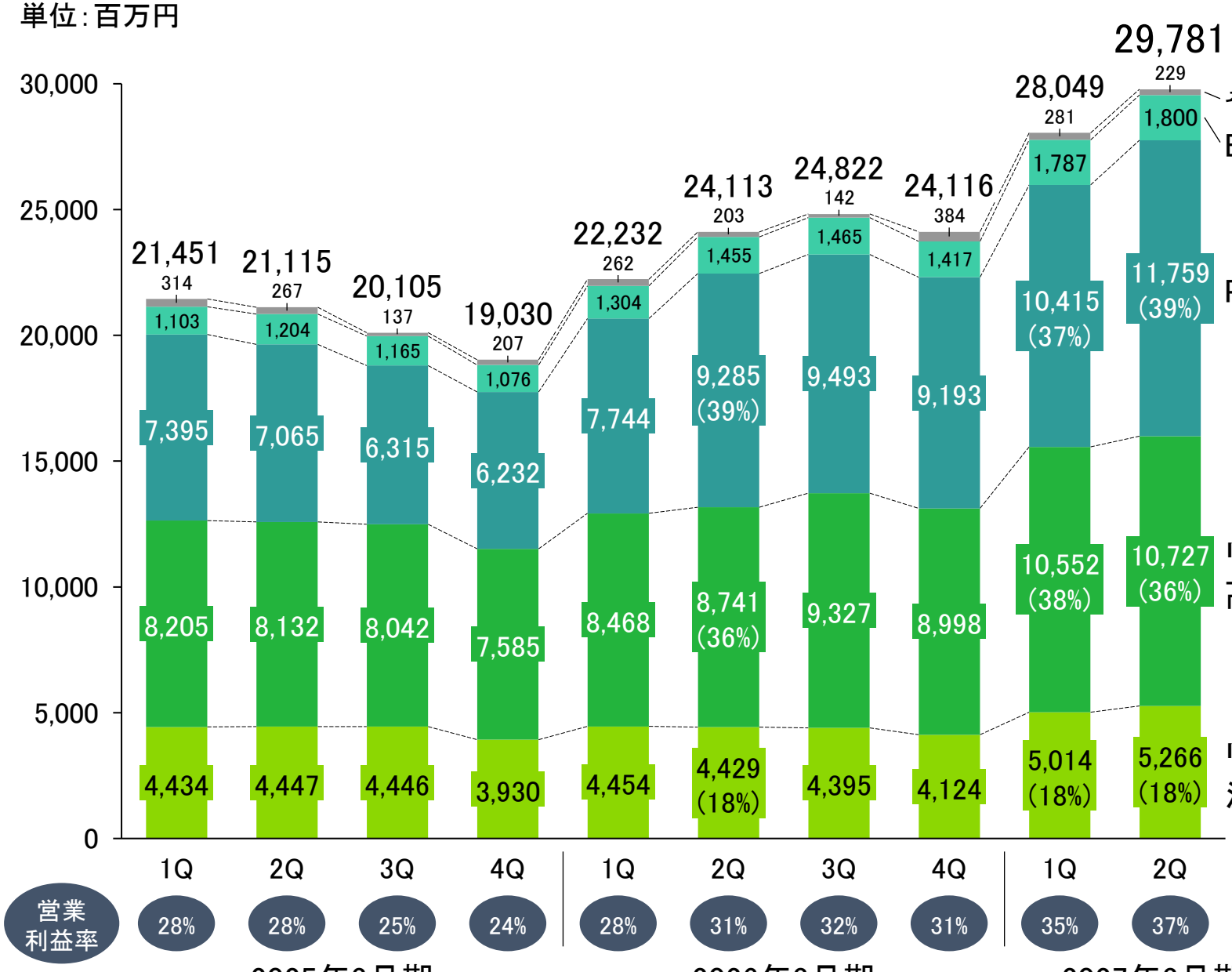
エレクトロニクス事業　製品分類

分野	分類		性状	用途
PCB用 絶縁材料	リジッド	汎用品	液状	表層保護・絶縁用SR材料 マーキング・エッチング・めっき用材料 電子機器用材料　等
		高機能品	液状／DF	
	PKG		液状／DF	
	フレキ		液状／DF	
	BU		液状／DF	層間絶縁・穴埋め用ビルドアップ材料　等
その他 関連商材	その他		液状／DF	導電性ペースト　等

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

エレクトロニクス事業　製品別売上高

単位：百万円



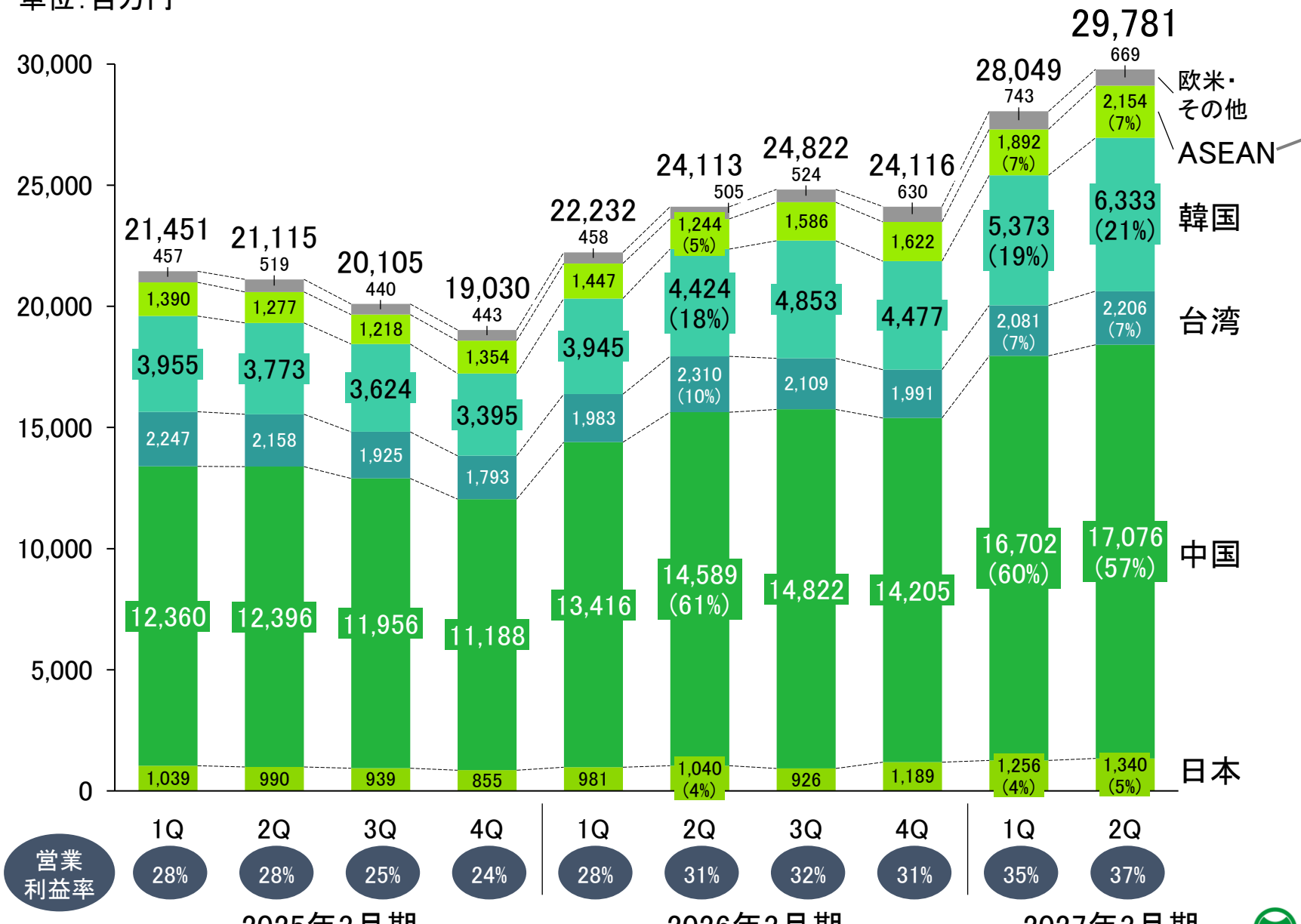
	前年同期比累計	前四半期比
その他 BU/フレキ	+828 (+30%)	+13 (+1%)
PKG	+5,144 (+30%)	+1,344 (+13%)
リジッド高機能	+4,070 (+24%)	+174 (+2%)
リジッド汎用	+1,396 (+16%)	+252 (+5%)

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

太陽ホールディングス

エレクトロニクス事業　販売地域別売上高

単位：百万円



	前年同期比 累計	前四半期比
欧米・その他 / ASEAN	+1,355 (+50%)	+262 (+14%)
韓国	+3,337 (+40%)	+960 (+18%)
台湾	△6 (△0%)	+125 (+6%)
中国	+5,773 (+21%)	+374 (+2%)
日本	+575 (+28%)	+83 (+7%)

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

医療・医薬品事業

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

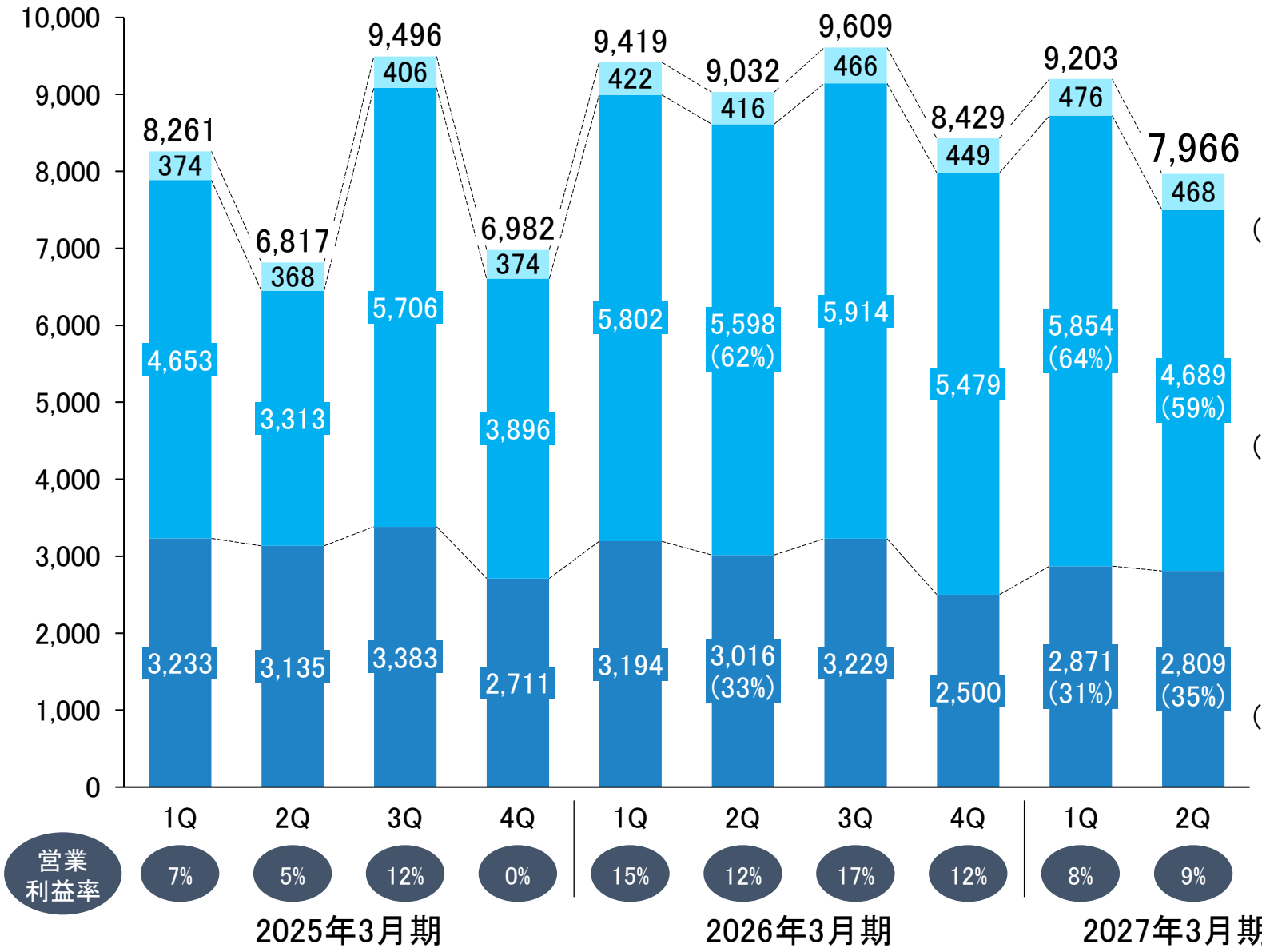
医療・医薬品事業　用語説明

用語	内容
長期収載品	新薬として発売された後に特許期間もしくは再審査期間が終了し、 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の販売が可能となっている先発品
CDMO	医薬品製造及び医薬品製剤開発を受託する機関 （Contract Development Manufacturing Organization）
GMP	医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準 （Good Manufacturing Practice）

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

医療・医薬品事業　会社別売上高

単位：百万円



	前年同期比 累計	前四半期比
マイ・スターズ（歯科技工）	+106 (+13%)	△8 (△2%)
太陽ファルマテック（製造受託）	△857 (△8%)	△1,165 (△20%)
太陽ファルマ（製造販売）	△530 (△9%)	△61 (△2%)

Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.

太陽ホールディングス



Copyright © TAIYO HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.